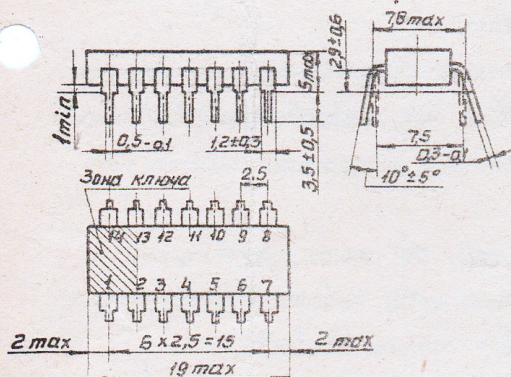




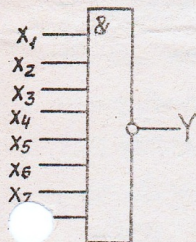
Паспорт
Микросхема К15552



Технические условия БКО.348.006ТУ
Функциональное назначение — логический
элемент „8И-НЕ“



Вес микросхемы не более 1г.



$$Y = \overline{X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8}$$

Выход	Назначение
1	Вход X ₃
2	Вход X ₄
3	Вход X ₅
4	Вход X ₆
5	Вход X ₇
6	Вход X ₈
7	Общий
8	Выход Y
9	—
10	—
11	Вход X ₁
12	Вход X ₂
13	—
14	Питание +E

Напряжение питания $E = +5.6 \pm 5\%$

Содержание золота в одной микросхеме 0,00696г.

Электрические параметры при температуре $+20 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование	Нормы
Нагрузочная способность, N	10
Время задержки выключения $t_{3, \text{нсек}}$, не более	22
Время задержки включения $t_{3, \text{нсек}}$, не более	15
Выходное напряжение „лог.0“ $U_{\text{вых.0}}$, В, не более	0,4
Выходное напряжение „лог.1“ $U_{\text{вых.1}}$, В, не менее	2,4

Предельно-допустимые условия эксплуатации:

Диапазон рабочей температуры от минус 10 до +70°C.

Предельно-допустимое кратковременное напряжение питания составляет 7В в течение времени 5миллисекунд.

Срок хранения - 12 лет.

Время гарантийной наработки.

Гарантируется соответствие микросхемы требованиям частных технических условий при наработке 10000 часов.

Гарантии исчисляются со дня отгрузки микросхем потребителю.

Указания и рекомендации по эксплуатации.

Крепление микросхемы к печатной плате в аппаратуре может быть произведено методом пайки выводов.

Расстояние от места пайки вывода до корпуса микросхемы должно быть не менее 2,5мм. Пайку следует производить с применением мер исключающих повреждение микросхемы из-за перегрева и механических усилий. При пайке рекомендуется применять припой ПОС-61 ГОСТ 1499-70 и флюс ФКСп по НО.054.063.

При пайке с помощью паяльника последний должен быть обязательно заземлен и иметь мощность не более 60Вт. При пайке температура не должна превышать 260°C, а время воздействия этой температуры на микросхему не более 5сек.

При монтаже руководствоваться указаниями черт. 0308.008Г4.

После монтажа микросхема должна быть защищена в соответствии с нормалью НО.054.021. С целью повышения надежности аппаратуры рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева корпуса микросхем и защиту от воздействия климатических факторов. При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

07К 197